

Karta techniczna

AG Copper

Pasta przewodząca ciepło na bazie miedzi przeznaczona do wypełniania połączeń procesor - radiator w celu polepszenia chłodzenia. Przewodność cieplna ~ 3,1 W/mK.

Zastosowanie:

wypełniania połączeń procesor - radiator,
nie nadaje się do aluminiowych radiatorów,
nie przewodzi prądu.

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Wygląd	-	pasta, miedziana
Zapach	-	bez zapachu
Temperatura topnienia	°C	-50
Temperatura zapłonu	°C	350
Gęstość	g/cm ³	2,9
Zakres temp. pracy	°C	-50 ~ 250

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1,5 ml	strzykawka	5	ART.AGT-060
14 ml	strzykawka	2	ART.AGT-061

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym miejscu. Pojemniki, gdy nie są używane, przechowywać szczelnie zamknięte. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe właściwości i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.